

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，董事会聘任了公司高级管理人员、指定董事会秘书代行人，现将具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司于2026年1月7日召开了2026年第一次临时股东会，采用累积投票方式选举王强先生、王靖女士、杨飞先生、许一帆女士、林俊勤先生、罗建华（KIN-WAHLOH）先生为公司第五届董事会非独立董事；选举胡贤君先生、彭宁先生、徐靖民先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

### 二、选举公司第五届董事会董事长

公司董事会选举王强先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

### 三、选举董事会各专门委员会委员

公司董事会选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，组成如下：

- 1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 王靖
- 2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤
- 3、提名委员会：彭宁（召集人）胡贤君 王强
- 4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

#### **四、聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任公司高级管理人员，具体如下：

- 1、聘任王强先生为公司总裁；
- 2、聘任何树泉先生为公司联席总裁；
- 3、聘任施君先生为公司副总裁；
- 4、聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

#### **五、指定董事会秘书代行人**

公司拟聘任施君先生为公司董事会秘书，鉴于施君先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司将待施君先生取得任职资格后再履行聘任程序。

施君先生同时为公司副总裁，在正式聘任前，董事会指定施君先生代行董事会秘书职责，施君先生简历详见附件。

施君先生联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 304。

联系电话：021-54155612

传真：021-64095577

电子信箱：ir@sz-lsi.com

公司对第四届董事会董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日

## 附件 简历

**王强先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳市正信同创投资发展有限公司执行董事，深圳市领先半导体产投有限公司执行董事，深圳市领先科技产业发展有限公司执行董事，深圳市领先半导体发展有限公司执行董事，南宁市先进半导体科技有限公司执行董事，深圳市旅游(集团)股份有限公司董事，先进封装材料国际有限公司董事。

**王靖女士**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历。深圳市旅游(集团)股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，先进封装材料国际有限公司董事。

**杨飞先生**，1967 年出生，中国国籍，香港永久性居民，本科学历。现任苏州桔云科技有限公司总经理，先进封装材料国际有限公司董事。曾任深圳领先科技产业发展有限公司总裁，美国塞灵思公司 (Xilinx Inc) 亚太总裁，美国赛普拉斯 (Cypress) 半导体公司事业部总经理，美国飞思卡尔 (Freescale) 半导体公司汽车芯片负责人，美国硅谷初创半导体公司 C-Cube Microsystem 总经理。

**许一帆女士**，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任 ASMPT 集团的全球执行副总裁兼首席财务官，执行副总裁和执行办公室成员。她拥有逾二十五年的金融专业经验，在技术、工业及人力资本服务行业的金融及投资者关系方面担任过职务。曾担任多家跨国企业全球或亚洲首席财务官，以及它们合资企业的非独立董事。

**林俊勤先生**，1959 年出生，马来西亚国籍，香港永久性居民，持有英国 University of Nottingham 生产工程及生产管理荣誉理学士学位。为半导体解决方案先进封装(AP)的高级包装首席顾问，曾任飞利浦电子有限公司 Philips Components 的光存储总经理。

**罗建华（KIN-WAH LOH）先生**，1954 年出生，马来西亚国籍，研究生学历，持有英国特许公认会计师公会（ACCA）会计与金融专业认证文凭及马来亚大学（吉隆坡）化学工程荣誉学士学位。现任 Synesys Technologies Holding（新加坡）董事长、Huba Control AG（瑞士）董事长、AMS AG（奥地利）董事、AEM Holdings Ltd（新加坡）独立董事、UTAC（新加坡）及日月新（中国）等公司董事。曾任恩智浦半导体（荷兰）全球销售与市场执行副总裁、奇梦达股份公司（德国慕尼黑）总裁兼首席执行官、英飞凌科技股份有限公司（德国慕尼黑）通信集团执行副总裁兼管理委员会成员，以及西门子组装/测试副总裁兼总经理。

**胡贤君先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。现任深圳市永明资产评估事务所执行事务合伙人。曾任深圳信永中和会计师事务所高级经理，深圳市中企华资产评估有限公司项目经理，河南二纺机股份有限公司财务。

**彭宁先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任北京市天同律师事务所高级顾问、律师，创维数字股份有限公司独立董事，深圳国际仲裁院兼职仲裁员。曾任深圳市中级人民法院副庭长、法官。

**徐靖民先生**，1956 年出生，中国国籍，香港永久性居民，硕士研究生学历，于 2022 年退休。曾任 Fairchild Singapore 高级工程师，ASMPT 集团营运长。

**何树泉先生**，1961 年出生，新加坡国籍，中国香港永久居民，硕士研究生学历。2021 年起担任先进封装材料国际有限公司（AAMI）首席执行官。何树泉先生从事半导体行业工作逾 40 年，精通过程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理。曾任 ASM 物料业务分部 CEO 等职位。

**施君先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司董事长、总裁，国信证券股份有限公司风险管理总部风控经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控总监，深圳市正信同创投资发展有限公司执行总经理和光智科技股份有限公司董事。兼任云南合续环境科技股份有限公司独立董事。

**李金福先生**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司财务总监，苏州桔云科技有限公司董事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）委派代表。曾任亚太会计师事务所深圳分所审计员，深圳市国弘资产管理有限公司财务经理，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监，深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）风控总监。